

μModule 電源產品具備 SnPb (錫鉛) BGA 封裝 適用於國防、航空及重型設備產業

加州 MILPITAS –2016 年 6 月 15 日– 凌力爾特 (Linear Technology) 日前發表具備 SnPb BGA 封裝的 53 款 μModule[®] (微型模組) 電源產品，鎖定主要使用含鉛焊錫之應用，如國防、航空及重型設備產業。μModule 負載點穩壓器具備 SnPb BGA 封裝，可簡化 PCB 板組裝，透過以下特性因應相關產業供應商需求，例如：

- 表面黏著 vs 通孔 PCB 封裝
- BGA 封裝的完整、包裹式 DC/DC 穩壓器電路 vs 高零件數、未驗證的離散方案
- 100% 經測試的負載點穩壓方案 vs 要求驗證及監督的離散電路負載點穩壓器方案
- 因相較於 flat LGA 或 QFN 封裝擁有更高的直立高度，可於 μModule BGA 封裝更簡單的清潔
- 回焊溫度與其他 PCB 上的錫鉛零組件相同 vs 更高溫度以因應具備無鉛錫膏負載點穩壓器要求

具備 SnPb BGA 封裝的 μModule 電源產品提供四種 DC/DC 轉換器類別：(1)具備單一或多個輸出的降壓轉換器(2) 升降壓轉換器 (3) 隔離式轉換器 (4)具備 PMBus 數位遙測，擁有 READ 及 WRITE 資料功能的轉換器


Pb-free (SAC305) 版本的元件及具備 BGA 與 LGA 封裝之超過 100 款 μModule 產品詳情請參閱 www.linear.com/umodule.

SnPb BGA μModule 電源產品更多內容請[按此](#)或網址 <http://lt.linear.com/00w>

圖說： SnPb (Tin-Lead) BGA 封裝的 μModule 電源產品

關於凌力爾特

凌力爾特(Linear Technology Corporation)為 S&P 500 公司之一，三十年來致力為全球主要公司設計、製造及行銷廣泛的高效類比 IC，該公司的產品在類比世界和數位電子產品間提供了關鍵的銜接，包括通訊、網路、工業、汽車、運算、醫療、儀器、消費性，以及軍事和航太系統。凌力爾特之產品涵蓋電源管理、資料轉換、訊號處理、RF 和介面 IC、μModule[®]子系統，以及無線感測網路產品。如需更多資訊請參閱 www.linear.com

 ,LT,LTC, LTM, 凌力爾特, 凌力爾特 logo 及 μModule 為凌力爾特註冊商標。其他商標為其個別持有者所有。

媒體聯繫：

Alice Wang
alice@ezwire.com
Tel: + 886-922552024

John Hamburger, 行銷總監
jhamburger@linear.com

Doug Dickinson, 媒體關係經理
ddickinson@linear.com
Tel: 408-432-1900 ext 2233